

SAMPLE LP CH20M22 PPX**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Le cadre optimal pour l'exploitation et l'innovation :**

Une électronique de fonctionnement innovante nécessite des "emballages" intéressants pour une intégration parfaite dans l'environnement système.

Le développement continu et l'extension conséquente du portefeuille de coffrets électroniques Weidmüller garantit une plateforme durable pour des applications électroniques de toutes formes de structures et de tous les domaines. Les informations CAO des circuits imprimés sont disponibles pour tous les boîtiers. Les raccordements à vis et à ressort sont disponibles.

La synergie conséquente du design, des techniques de raccordement et de la fonctionnalité constitue une base optimale pour que la conception de vos systèmes électroniques corresponde au marché et aux applications auxquelles ils sont destinés.

Le fonctionnement, la forme et la finition se marient en une unité logique d'un niveau de sécurité et de commande élevé.

Informations générales de commande

Version	Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M , Plaque de circuit imprimé pour équipement personnalisé CH20M22, Largeur: 22.5 mm
Référence	1105580000
Type	SAMPLE LP CH20M22 PPX
GTIN (EAN)	4032248880652
Qté.	1 pièce(s)

SAMPLE LP CH20M22 PPX

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	22,5 mm	Largeur (pouces)	0,886 inch
Poids net	24,8 g		

Températures

Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	120 °C
--------------------------------------	--------	--------------------------------------	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-92	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-27-02

Caractéristiques des matériaux

Groupe de matériaux isolants	II	Matériau isolant	PA 66 GF 30
------------------------------	----	------------------	-------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	MB DEVICE MANUF. EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

SAMPLE LP CH20M22 PPX**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dessins**

Layer Stack Up Detail for: 1105580000_03.PcbDoc

Layer Name	Order	Material	Thickness	Dielectric	Dielectric	Dielectric
				Modulus	Material	Type
Top Solder Mask	1.075D		0.015mm		Solder Resist	
Top Layer	1.07L		0.035mm		FR-4	Core
Bottom Layer	1.08L		0.035mm		FR-4	Core
Bottom Solder Mask	1.085D		0.015mm		Solder Resist	
PCB thickness over all 1.6mm +/- 0.13mm						

